

2013年3月期 決算会社説明会



当社トピック

- 市場の“流れ”を**コンプレッション**に
- 株式会社東進(韓国:金型製造)を連結子会社化
- 海外ローカル市場でリピート金型を捕捉
- シンギュレーション事業で拡販開始

- 新マーケット戦略「北米拠点に評価・実験ラボ設置」
- 大判化・最先端PKG対応の要素技術開発
- 「夢の金型」開発を継続
- 知的財産戦略でも成果

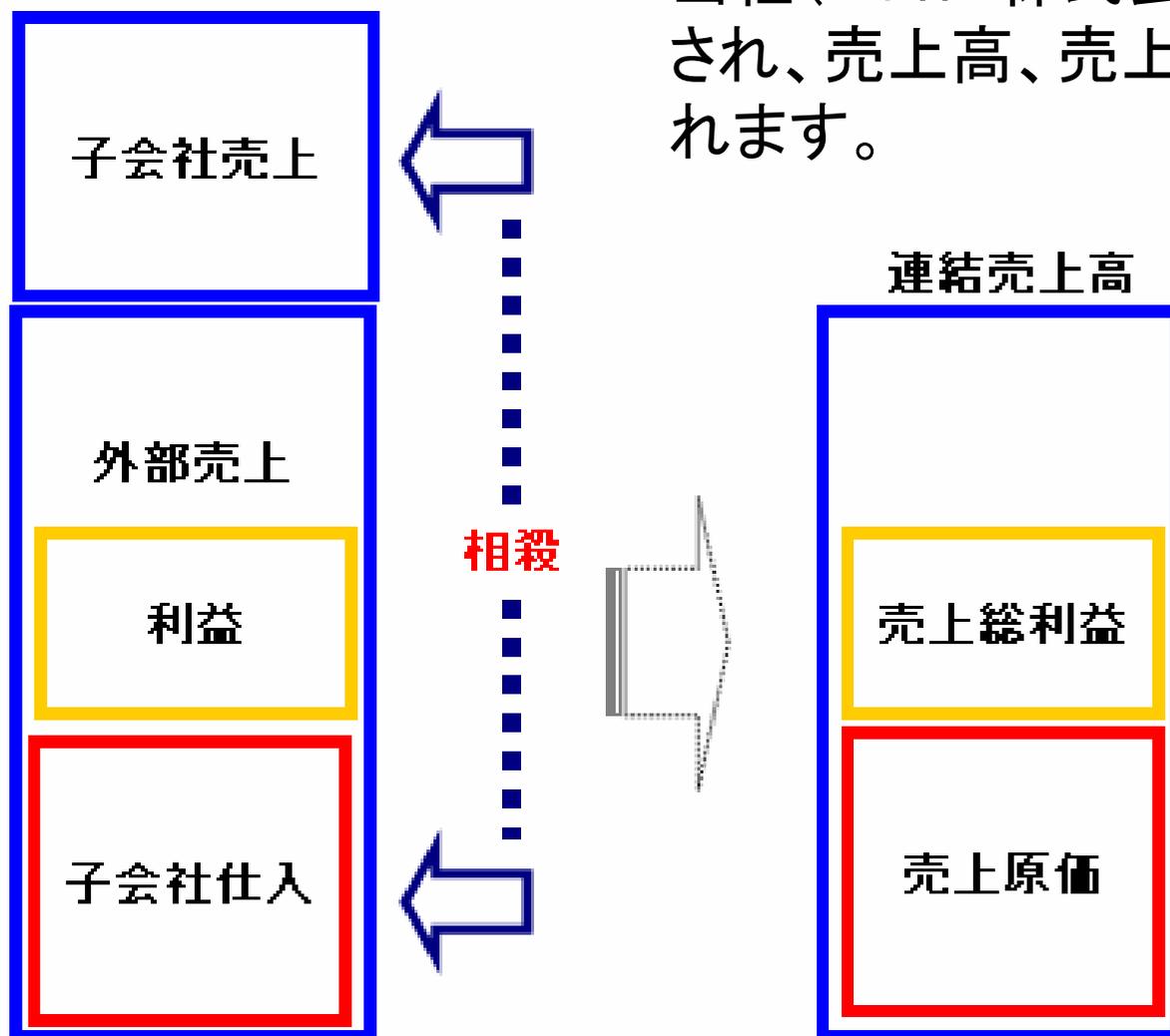
当社トピック

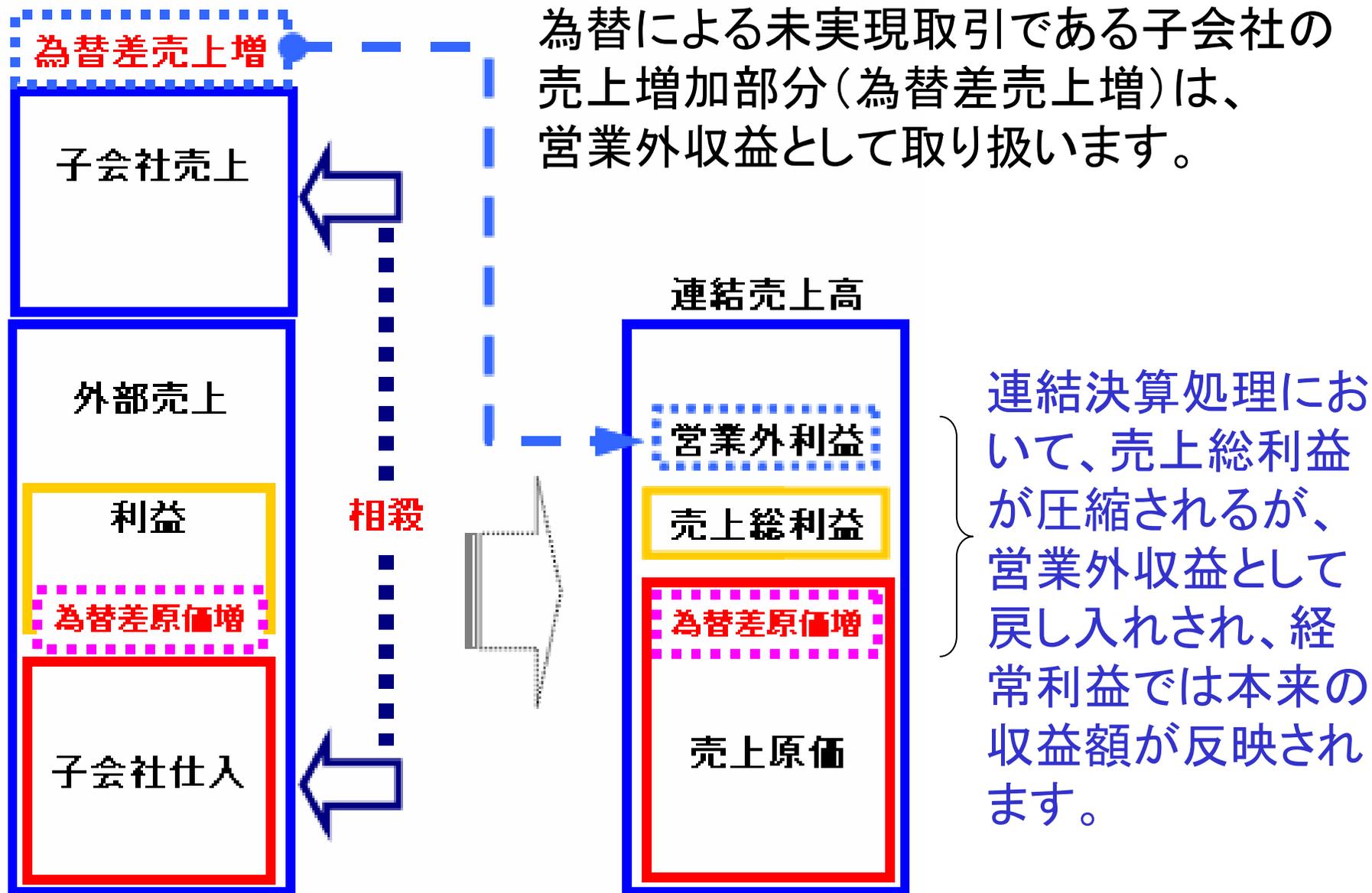
2013/3期 連結業績

(億円)

	通 期
売 上 高	164.5
営 業 利 益	▲4.4
経 常 利 益	6.6
当 期 純 利 益	6.9

連結決算において、子会社の売上高と当社(TOWA株式会社)の仕入高は相殺され、売上高、売上原価、利益が算出されます。





2013/3期 連結P/L

		通期	(億円)
売	上	高	164.5
売	上	原 価	126.9
売	上	総 利 益	37.6
販	管	費	42.0
営	業	利 益	▲4.4
	為替差益	10.3	8.9億円 為替差 売上増部分
経	常	利 益	

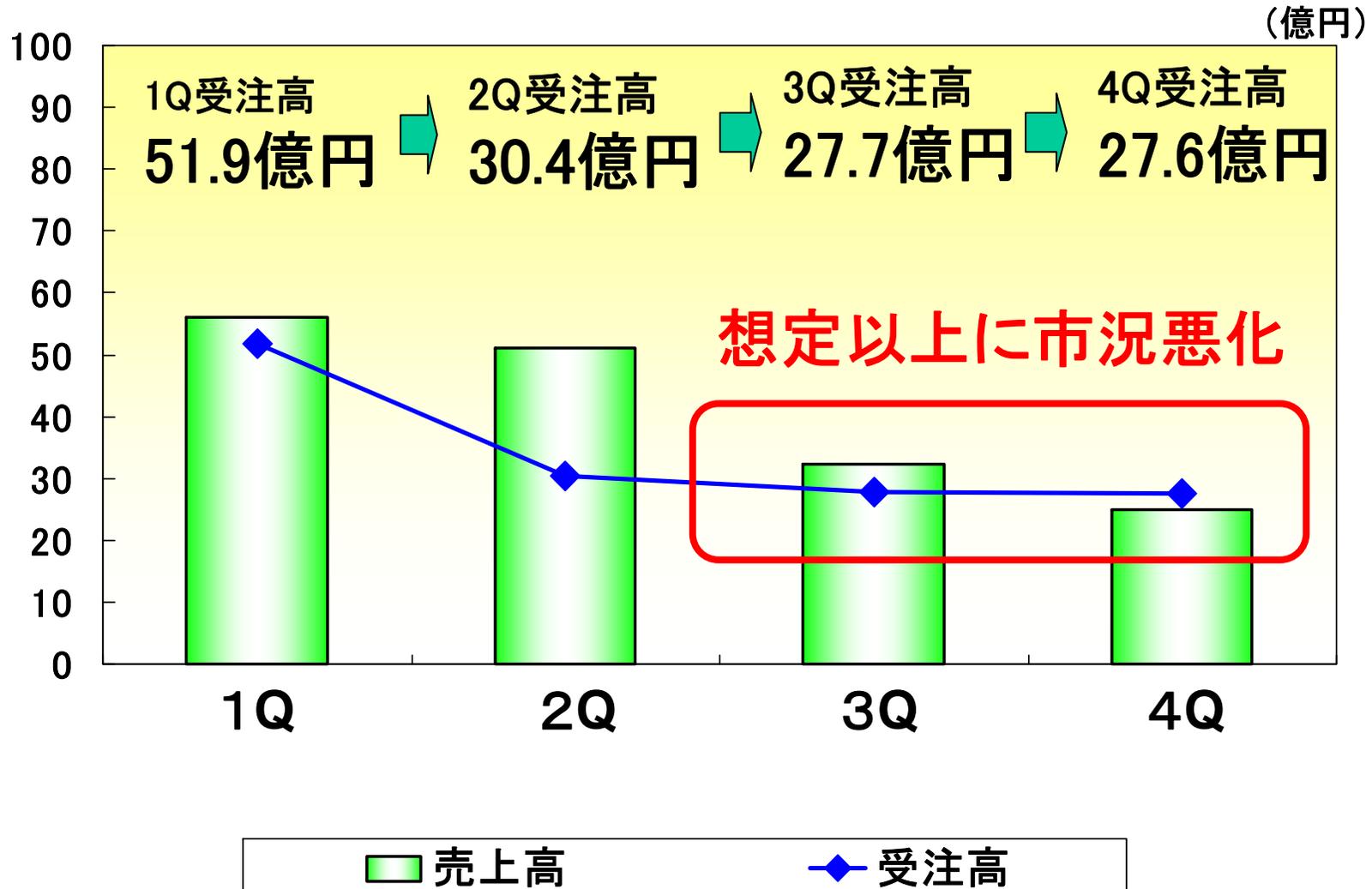
収益として認識すること変わらない

2013/3期 連結業績(上・下)

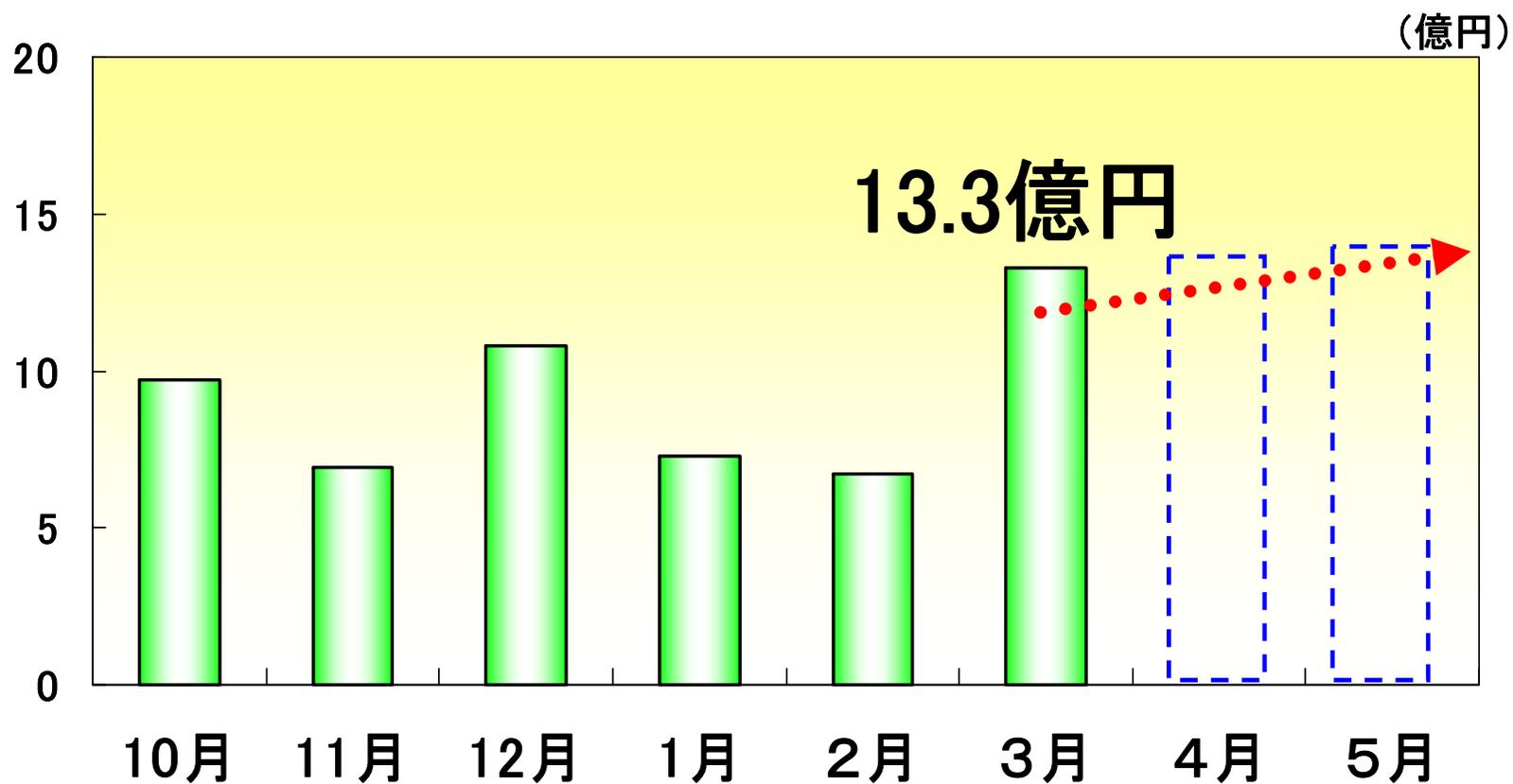
(億円)

	上期	下期	通期
売上高	107.2	<i>57.3</i>	<i>164.5</i>
経常利益	15.2	<i>▲8.6</i>	<i>6.6</i>
当期純利益	14.7	<i>▲7.8</i>	<i>6.9</i>

受注高・売上高の推移



(月次) 受注高推移



1月～2月で底打ち、市況は反転

研究開発・設備投資

(百万円)

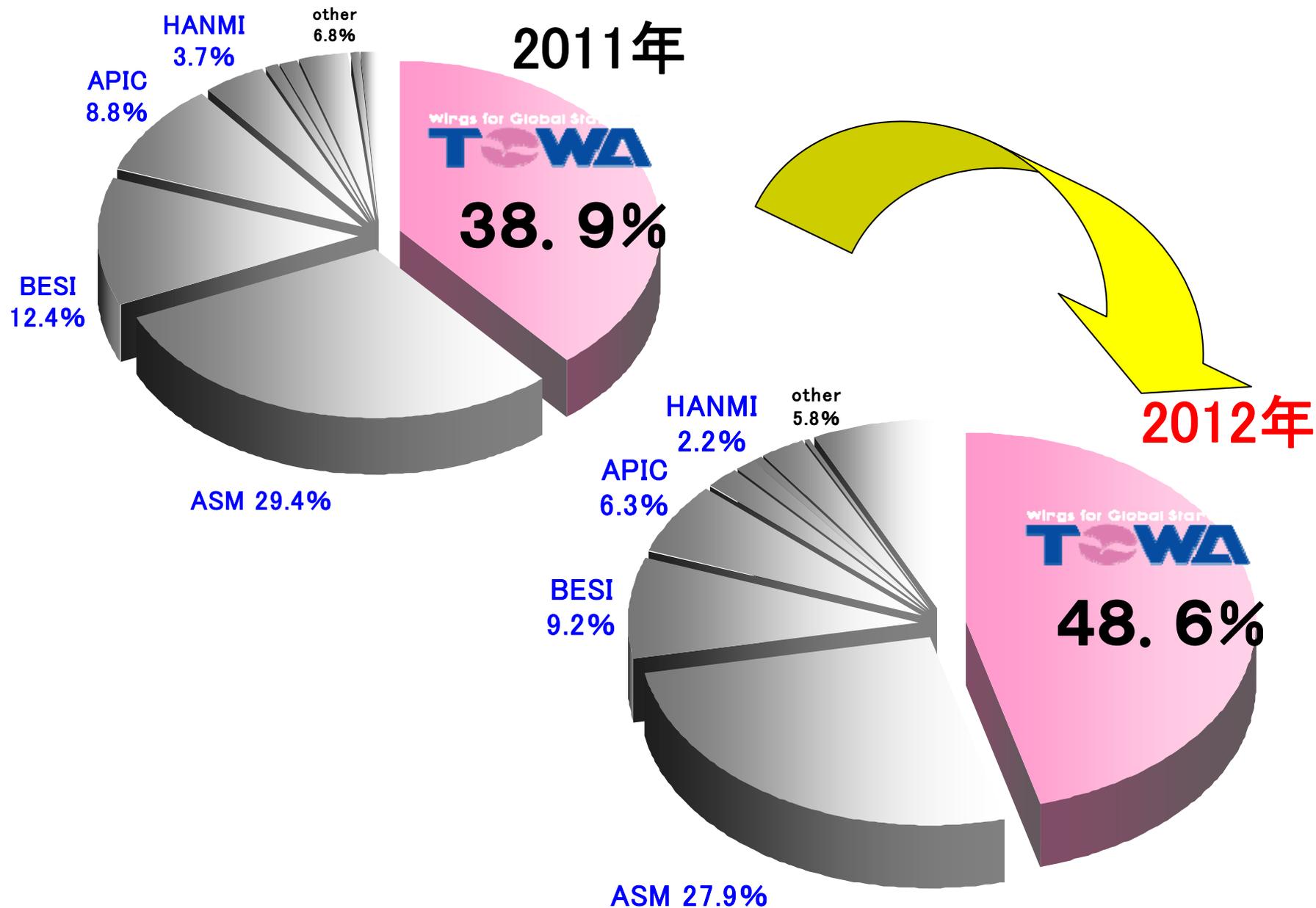
	期初計画	実績
研究開発費 (対売上比%)	360 (2.0%)	187 (1.1%)
設備投資	1,450	1,262

※研究開発費は費用処理できるもののみ

配当・その他指標

(百万円)

	2011/3期	2012/3期	2013/3期
配 当	10.0円	5.0円	10.0円
(連結配当性向)	6.7%	12.9%	36.2%
EPS (@1株 当期純利益)	150.0円	38.7円	27.6円
BPS (@1株 純資産)	590.5円	636.7円	674.6円



2013年3月期

【総括】

- ・市況が悪い中、まずまずの業績を残せた
- ・次期以降の業績に寄与する施策は打った
- ・長期的、グローバルな経営戦略の強化

2014年3月期

事業・業績計画

1、TOWA韓国株式会社の新規設立

(1) 会社概要

- 会社名 : TOWA韓国株式会社
- 所在地 : 韓国(Seoul市)
- 株主構成 : TOWA株式会社100%
- 設立日 : 2013年4月8日

(2) 目的

お客様への技術サポートを伴った営業活動の展開が可能となる体制を構築。株式会社東進(前期に連結子会社化)との製販一体となった活動も推進する。

2、合併会社(台湾)の連結子会社化

会社名 : 巨東精技股份有限公司

所在地 : 台湾(高雄市)

株主構成 : TOWA株式会社 40%
JIPAL CORPORATION 60%

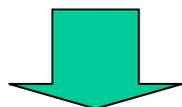
第三者割当増資の実施
(TOWA全額引受)

株主構成 : TOWA株式会社 60%
JIPAL CORPORATION 40%

このような動きの狙いは・・・

「マーケットイン型」 営業・生産・サービス網の構築

半導体メーカー、ファンドリー、アッセンブリハウスに
対して、開発段階で試作金型・成形評価等を提供



- エンジニアを常駐（技術営業）
- 最先端技術の取り込みが可能
- 評価プレス・金型の設置

トータルソリューション
サービス

お客様の近くで

試作金型・評価用プレスを設置
北米で成功 ⇒ 横展開を検討

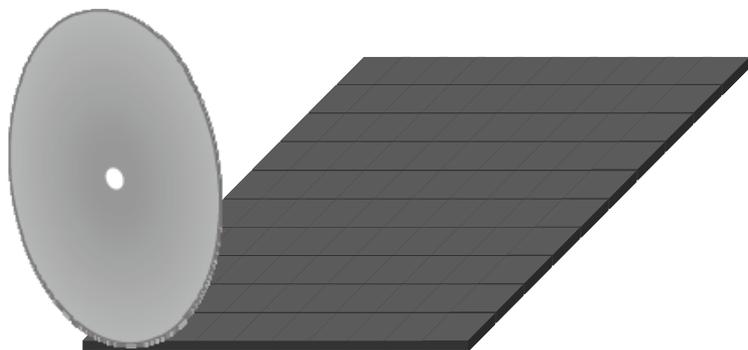
北米ファブレス企業

ヨーロッパへの
展開を検討

量産装置の
受注へ

3、シンギュレーション事業

Semiconductor & LED



FMS 3040



年間売上高目標 **16.6億円**

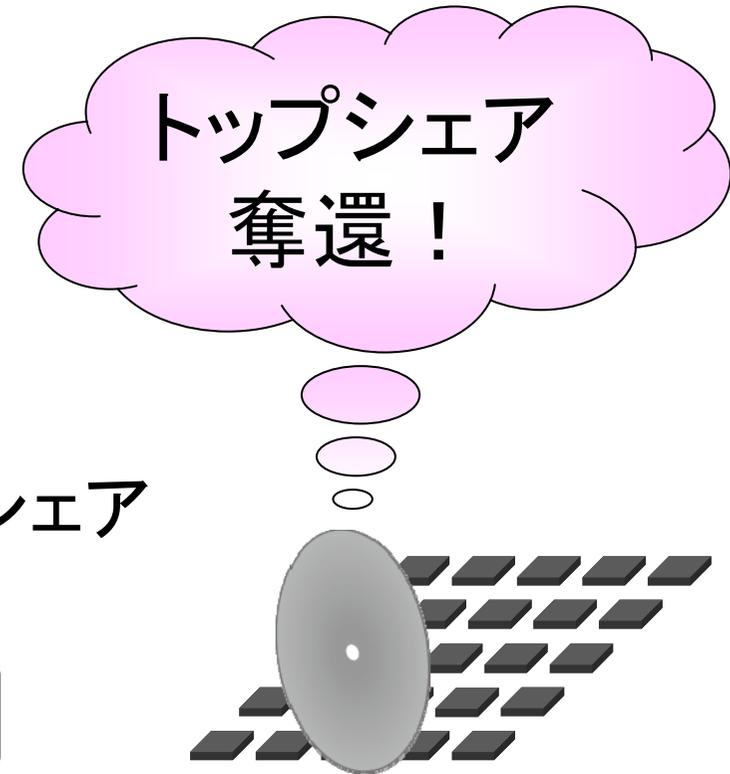
(2013/3期実績 4.0億円)

製品競争力

- ★自社製ダイサー搭載
- ★UPH 30,000
- ★モールド工程でのマーケットシェア

供給体制

- ★中国(TOWA蘇州)工場に生産・組立ライン設置
- ★部材現地調達、海外生産 → 原価低減
- ★直出荷体制 → 納期短縮



4、コンプレッション元年

**PMC1040-D
(ダブルレイヤー)**

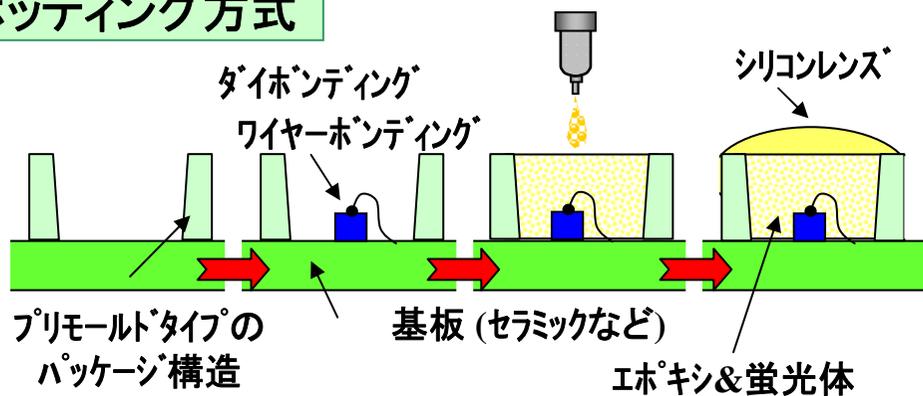


**LCM1010
(LED樹脂封止)**

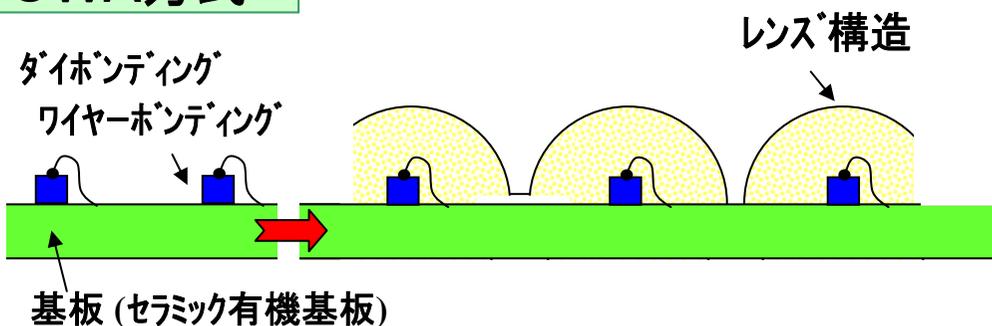


LEDの樹脂封止工程

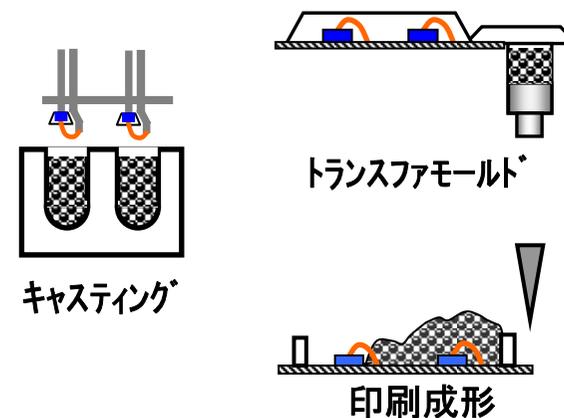
ポットイング方式



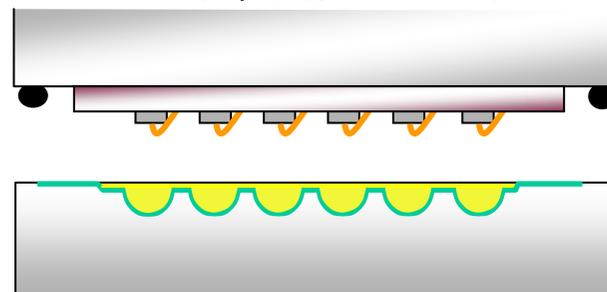
TOWA方式



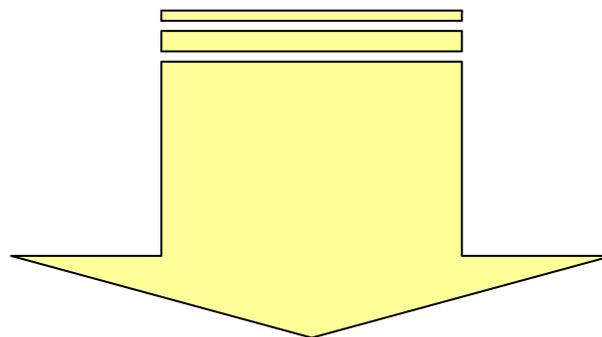
他の樹脂封止方法



コンプレッションモールド



コンプレッション技術

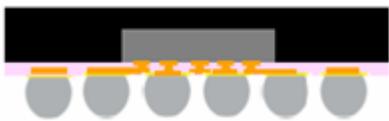


半導体製造のブレークスルーに

最先端の半導体PKGコンセプトを コンプレッション技術によって実現

Fan-Out Wafer Level Package

FOWLP



- Wire Less
- 基板Less
- Wafer Fabが組立可能

実現

Compression Molding System

- 樹脂流動なし
- 成形厚み可変
- 樹脂コストダウン
- 高い成形信頼性
- etc...

5、ホールドフレーム方式

- 世界最高精度のプレス
- YPM(トランスファ方式) 150t→180t

6、知的財産戦略

- 技術優位の地固め
- ビジネスチャンスへ

7、「夢の金型」

- 離型性へのチャレンジ
- “金型”にイノベーション

2014 / 3 期 業績計画

(億円)

通期計画	
売上高	185.0
営業利益	11.0
経常利益	10.0
当期純利益	9.0

2014/3期 業績計画(上・下)

(億円)

	上期	下期	通期
売上高	80.0	<i>105.0</i>	<i>185.0</i>
営業利益	2.0	<i>9.0</i>	<i>11.0</i>
経常利益	1.9	<i>8.1</i>	<i>10.0</i>
当期純利益	1.2	<i>7.8</i>	<i>9.0</i>

配当予想

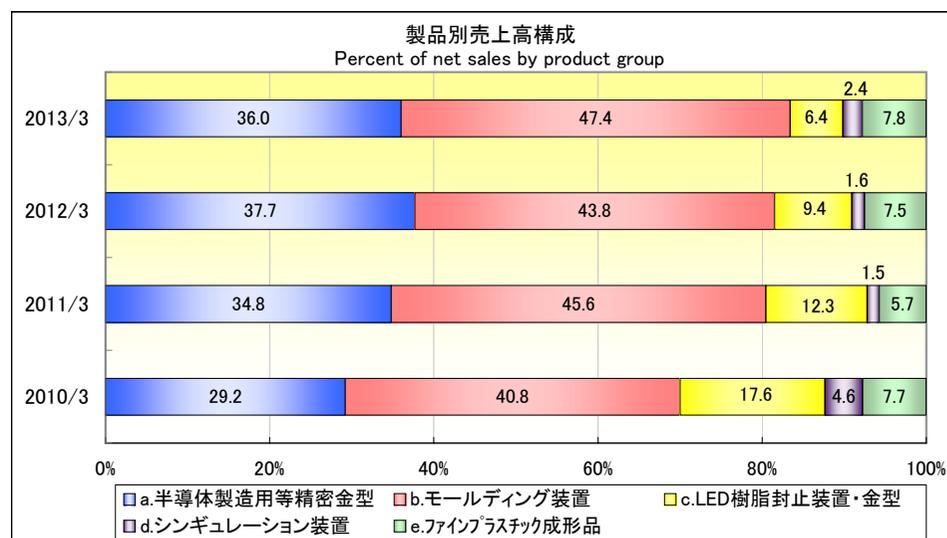
(円. 銭)

	年間配当金
2014年3月期(計画) (連結配当性向)	10.00 (27.8%)

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Ordinary income to net sales

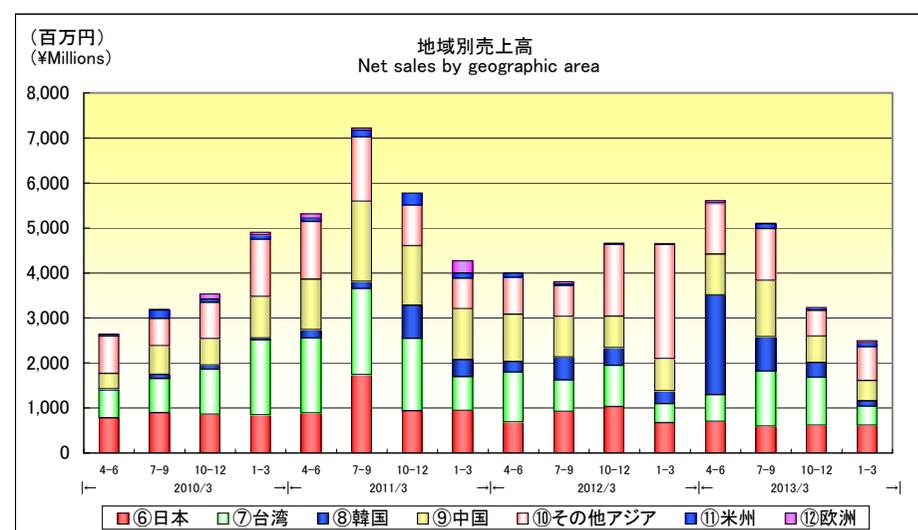
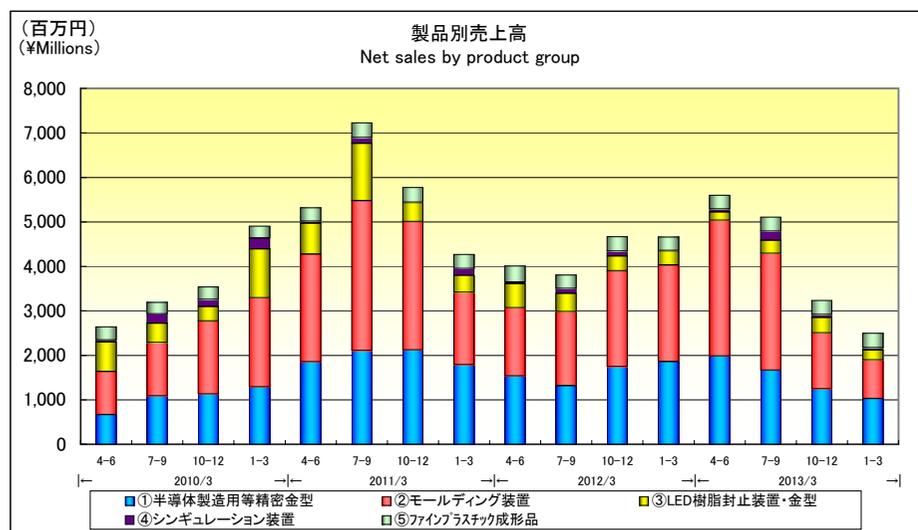


a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2012/9
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	Net sales	14,274	22,592	17,140	16,454	10,715
経常利益	Ordinary income	-345	4,064	1,672	663	1,523
当期純利益	Net income	-330	3,751	968	691	1,468
総資産	Total assets	26,738	27,288	26,817	25,896	27,124
純資産	Net assets	11,091	14,771	15,926	17,072	16,990
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	-13.19	150.00	38.71	27.64	58.70
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	-3.0	29.0	6.3	4.2	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	-1.3	15.0	6.2	2.5	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	-2.4	18.0	9.8	4.0	14.2
自己資本比率	Equity ratio	41.5	54.1	59.4	65.2	62.0

(単位: 百万円/¥Millions)

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

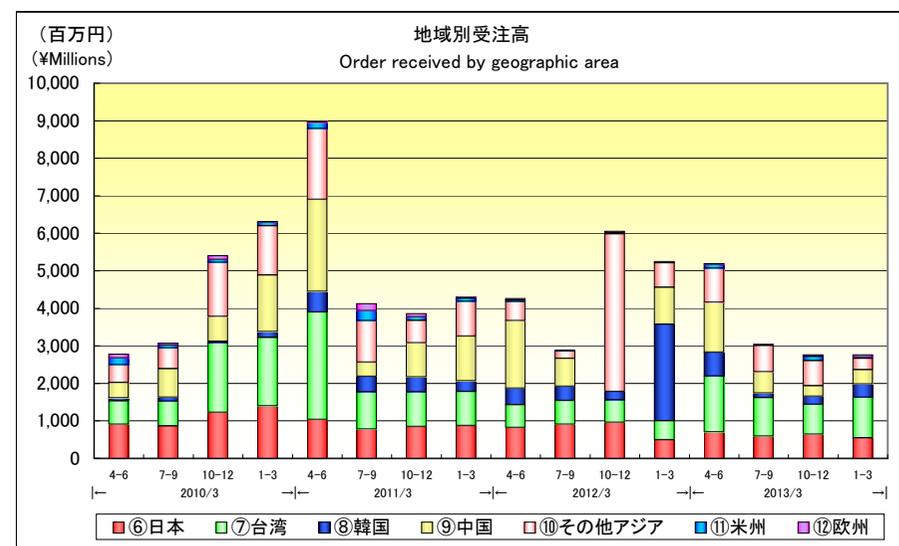
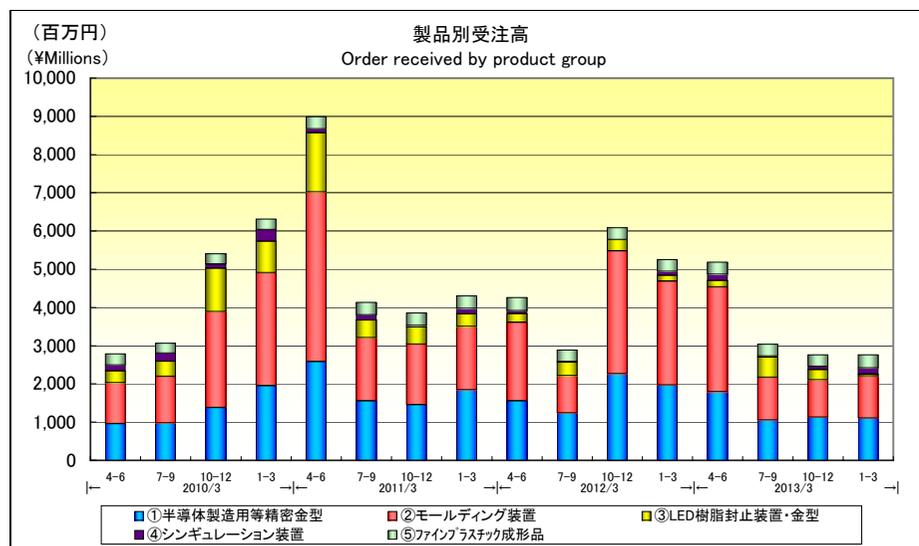
決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923
モールドング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	973	1,200	1,645	2,007	5,826	2,421	3,371	2,888	1,630	10,313	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	48	206	156	246	657	40	127	13	155	337	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395
ファインプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277
月平均	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371

地域別売上高 Net sales by geographic area

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454
日本 ⑥ Japan	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521
台湾 ⑦ Taiwan	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314
韓国 ⑧ Korea	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428
中国 ⑨ China	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189
その他アジア ⑩ Other asia	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604
米州 ⑪ America	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269
欧州 ⑫ Europe	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位:百万円/¥Millions)

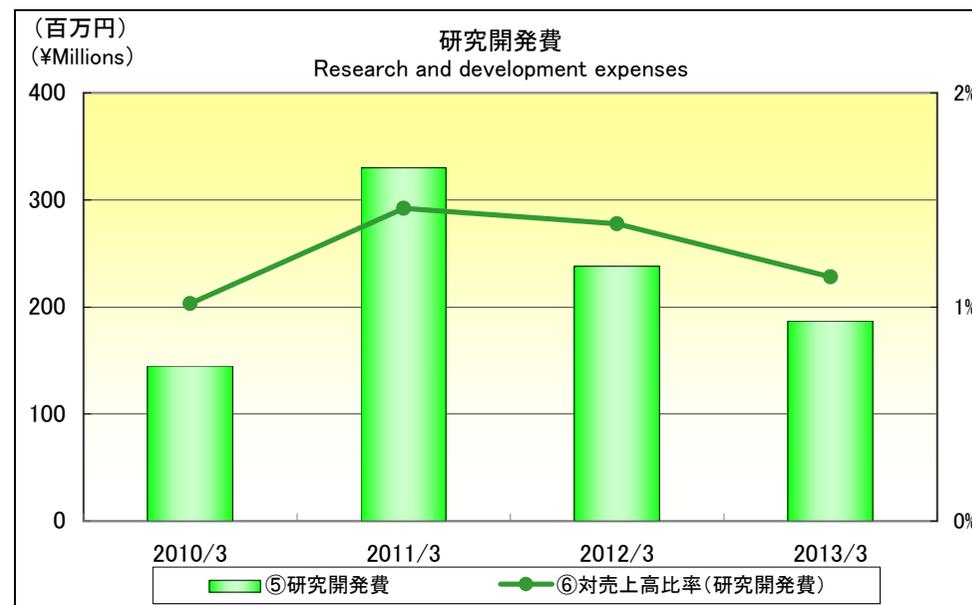
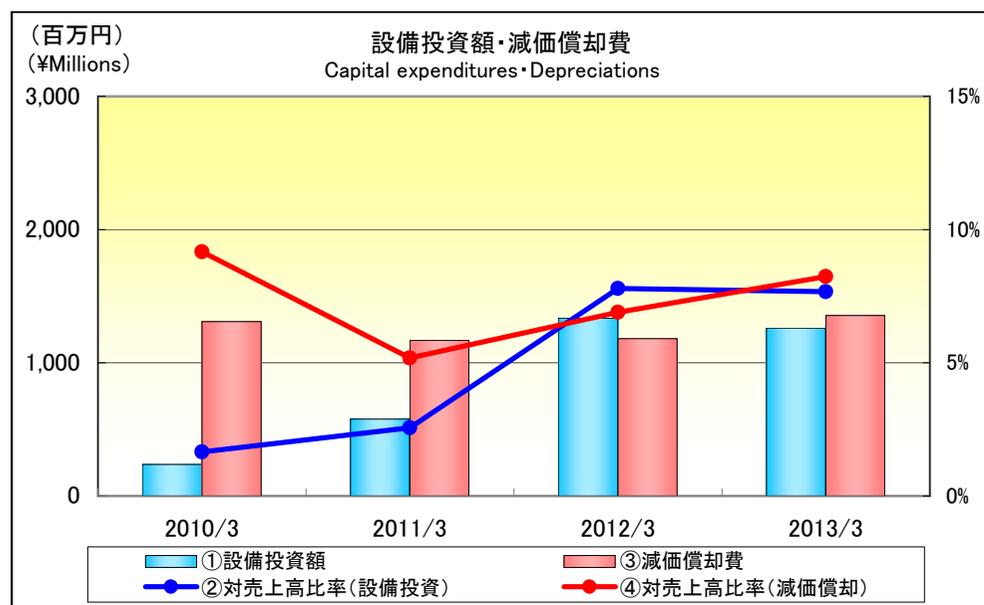
決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083
モールドディング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	1,069	1,220	2,506	2,954	7,751	4,437	1,651	1,587	1,657	9,334	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	147	212	111	300	772	101	132	35	142	411	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439
ファインプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279
月平均	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147

地域別受注高 Order received by geographic area

(単位:百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759
日本 ⑥ Japan	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494
台湾 ⑦ Taiwan	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392
韓国 ⑧ Korea	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328
中国 ⑨ China	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566
その他アジア ⑩ Other asia	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579
米州 ⑪ America	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263
欧州 ⑫ Europe	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	(単位: 百万円/¥Millions)			
決算期	Fiscal year	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,494	5,571	1,897	2,710
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-290	-620	-112	-1,083
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-2,733	-3,808	-2,280	-817
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,836	4,933	4,395	5,266
設備投資額	①Capital expenditures	236	578	1,336	1,262
対売上高比率	②Ratio of sales	1.65	2.56	7.79	7.67
減価償却費	③Depreciations	1,309	1,170	1,181	1,354
対売上高比率	④Ratio of sales	9.17	5.18	6.89	8.23
研究開発費	⑤Research and development expenses	145	330	238	187
対売上高比率	⑥Ratio of sales	1.02	1.46	1.39	1.14

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。